

证券代码：874701

证券简称：永志股份

主办券商：华泰联合

江苏永志半导体材料股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

2026年3月9日，江苏永志半导体材料股份有限公司（简称“公司”或“发行人”）第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

- 本次发行股票的种类：人民币普通股。
- 发行股票面值：每股面值为1元。
- 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过3,777.7100万股（含本数，不含超额配售选择权），不超过4,344.3665万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

本次公开发行的股票全部为公司公开发行的新股，不安排公司原股东公开发售股份。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

- 定价方式：

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5、发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

6、发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

7、募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，计划投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金使用额 (万元)
1	半导体封装材料扩产建设项目	23,414.51	23,414.51
2	异形铜带及模具制造项目	10,500.97	10,500.97
3	研发中心建设项目	8,205.47	8,205.47
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		50,120.95	50,120.95

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

8、发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

9、发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

10、决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。如在此有效期内通过北交所上市委审核，则本次发行上市决议的有效期自动延续至公司本次发行上市相关事项完成之日；若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东会授权董事会决议适当延长有效期。

11、承销方式：本次发行采取主承销商余额包销的方式。

12、拟上市地：北京证券交易所。

13、其他事项说明：

本次发行上市的最终方案以北交所审核并经中国证监会同意注册的方案为准。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的《公开转让说明书》，公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 247.92 万元、6,008.64 万元；加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 0.60%、

13.27%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

三、 备查文件

江苏永志半导体材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

江苏永志半导体材料股份有限公司

董事会

2026年3月9日